

Title (en)

Device for vacuum-tight sealing of electron tubes

Title (de)

Einrichtung zum vakuumdichten Verschliessen von Elektronenröhren

Title (fr)

Dispositif pour le scellement étanche au vide de tubes à électrons

Publication

EP 0693767 A1 19960124 (DE)

Application

EP 95109961 A 19950627

Priority

DE 4425160 A 19940718

Abstract (en)

The device has a vacuum pump system (2), for evacuating the interior of the electron tube (1), which is coupled to the vacuum pump system via a connection element (4), before melting to form a vacuum-tight seal. The melting is effected by a melting system (5) with an electric heating coil (6), enclosed both radially and axially by a housing (13) which has a component (14) which can be removed from the side, together with the heating coil. The removable housing component is secured in place by a spring (15). <IMAGE>

Abstract (de)

Einrichtung zum vakuumdichten Verschließen von Elektronenröhren mit einem Vakuumpumpensystem (2) einem rohrförmigen Verbindungselement (4) zwischen Elektronenröhre (1) und Vakuumpumpensystem (2), welches nach der Evakuierung der Elektronenröhre dauerhaft vakuumdicht durch Abschmelzen verschlossen wird, wobei das Abschmelzen durch eine spezielle Abschmelzeinheit (5) ausgeführt wird und die Abschmelzeinheit mit einer Heizwendel (6) ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizwendel (6) von einem Gehäuse (13) radial und axial umfaßt wird und ein Bauteil (14) des Gehäuses (13) seitlich herausnehmbar ist, wobei mit dem Bauteil (14) auch die Heizwendel (6) herausnehmbar ist, ohne daß Verschraubungen gelöst werden müssen und daß zur Halterung des Bauteils (14) ein Arretierelement (15), z.B. eine Feder, vorhanden ist. <IMAGE>

IPC 1-7

H01J 9/40

IPC 8 full level

H01J 9/40 (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

H01J 9/38 (2013.01 - KR); **H01J 9/40** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

[A] US 3100251 A 19630806 - JOHNSON FREDERIC R

Designated contracting state (EPC)

DE FR IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0693767 A1 19960124; **EP 0693767 B1 19990825**; CN 1118513 A 19960313; DE 4425160 A1 19960125; DE 59506675 D1 19990930; JP H0845430 A 19960216; KR 960005674 A 19960223; TW 265455 B 19951211; US 5567193 A 19961022

DOCDB simple family (application)

EP 95109961 A 19950627; CN 95107586 A 19950718; DE 4425160 A 19940718; DE 59506675 T 19950627; JP 16885195 A 19950704; KR 19950014840 A 19950605; TW 84105543 A 19950601; US 46448495 A 19950605